

募集要項

企業データ

社名 DOWAホールディングス株式会社	売上高 (2017年3月期) 4,105億300万円(連結)
所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル 22階	経常利益 (2017年3月期) 365億400万円(連結)
創業 明治17(1884)年	事業内容 1. 総合環境リサイクル事業(廃棄物処理、貴金属リサイクル、汚染土壌回復) 2. 非鉄金属製錬事業 3. 電子材料事業(半導体材料、機能材料、電子材料) 4. 金属加工事業 5. 工業炉製造・販売、熱処理事業(表面処理)
資本金 364億3,700万円	事業所 本 社/東京 営業所/大阪、愛知、静岡、福岡 研究所/環境技術研究所、製錬技術研究所、機能材料研究所、 半導体材料研究所、電子材料研究所、技術センター(金属加工)、 技術開発センター(熱処理) 工 場/秋田、栃木、群馬、埼玉、千葉、長野、静岡、愛知、岡山、福岡、 熊本 海 外/中国、台湾、タイ、シンガポール、インドネシア、インド、ミャンマー アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、チェコ
代表者 代表取締役社長 山田 政雄	
従業員数 (2017年3月末時点) 6,225名(連結)	

採用データ

採用予定数 技術系：30名 事務系：10名	初任給 (2017年4月実績) 修士了：242,500円 学部卒：218,000円 高専卒：188,000円
職種 技術系/研究開発、製造・生産技術開発、プラント設計・保守 生産管理、品質管理 事務系/企画、営業、経理、人事、労務、総務、法務	諸手当 通勤費(全額支給)、超過勤務手当、住宅手当 ほか
勤務時間 本 社/9:00~17:25(フレックスタイム制) 事業所/8:00~16:00ほか(勤務地による)	昇給・賞与 昇給：年1回(4月) 賞与：年2回(6月、12月)
勤務予定地 全国各地(本社、営業所、研究所、工場)、海外	寮・社宅 完備(本社、営業所、研究所、工場などの勤務地周辺)
	休日・休暇 週休2日、祝祭日、メーデー、創立記念日、年末年始、 有給休暇(10~22日)、慶弔休暇、特別休暇、リフレッシュ休暇 ほか

応募について

選考方法 面接、適性検査	提出書類 1. 技術系 (1) 学科推薦 学科推薦書、当社指定履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書 (院生の方は、学部時の成績証明書、卒業証明書も提出) 現在の研究テーマをまとめたレジュメ(A4用紙2枚)を提出 (2) 自由応募 エントリーシート 現在の研究テーマをまとめたレジュメ(A4用紙2枚)を提出 2. 事務系 エントリーシート
試験日 エントリーシート、適性検査より順次実施	書類提出先 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル 22階 DOWAホールディングス株式会社 人事・人材開発部門 部長 稲葉 修 宛
交通費 当社規定により支給	
応募方法 1. 学科推薦(技術系応募のみ受付) 応募提出書類は随時受け付けていますので、ご郵送ください ※日程調整のうえ、1日で全ての試験を実施 2. 自由応募 採用ホームページ上でご応募ください URL： http://www.dowa.co.jp/saiyou/	

担当：今元・高橋・森・向山
TEL：0120-268862(フリーダイヤル)/03-6847-1102(直通)
E-Mail：saiyou@dowa.co.jp

DOWAホールディングス株式会社